

Примерные вопросы к тесту по САПР

1. Что общего и чем отличаются гибридные, совмещенные и полупроводниковые ИС?
2. Сравните методы получения тонких пленок.
3. Как выбирается ширина тонкопленочного резистора?
4. Что и как изменится, если длину и ширину пленочного резистора увеличить в два раза?
5. Какие достоинства и недостатки толстопленочных ИС?
6. Сравните методы изготовления двусторонних печатных плат.
7. Перечислите методы изготовления многослойных печатных плат.
8. Перечислите критерии безотказной работы.
9. В чем главное отличие надежности аппаратуры и программ?
10. Перечислите виды обеспечения САПР.
11. Что дает использование блочно-иерархического подхода к проектированию)?
12. Какие основные причины использования методов автоматизированного проектирования?
13. В чем сложность конструкторского этапа проектирования ЭВМ? Какие задачи решаются на этом этапе?
14. Какие основные достоинства и недостатки канального алгоритма?
15. Какие задачи решаются на этапе компоновки?
16. В чем состоит основная цель задачи размещения элементов?
17. Какие задачи решаются на этапе трассировки межсоединений?
18. Какие этапы включает итерационный алгоритм?
19. Сравните алгоритмы трассировки.
20. Как Вы понимаете термин «полузаказное» проектирование?
21. Сравните методы «заказного» проектирования БИС.
22. Для чего делается стоимостной анализ при проектировании БИС?
23. Что общего и чем отличается проектирование БИС на стандартных элементах и на базовых матричных кристаллах?
24. Перечислите достоинства и недостатки кремневого компилятора.

Задача

1. Соединить точки А и В волновым алгоритмом с проставлением путевых координат.

